

## IBM, 토크로닉스(Tokyo Electron)와 함께 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 시작함

- 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임

- 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임

IBM, 2022년 8월 1일 - IBM과 토크로닉스(Tokyo Electron, TEL)는 300mm 웨이퍼 3D NAND 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임.

IBM은 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임. 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임.

3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임. 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임.

IBM과 TEL은 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임. 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임.

3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임. 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임.

2018년부터 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임. 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임.

IBM은 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임. 3D NAND 300mm 웨이퍼 생산을 위한 3D NAND 기술을 개발하고, 이를 통해 성능과 효율을 높임.

<https://kr.newsroom.ibm.com/announcements?item=122723>